

2023年12月14日

## Patentix 株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

日電精密工業株式会社  
代表取締役社長 吉田圭二

日電精密工業株式会社は、立命館大学発ベンチャーの Patentix 株式会社（本社：滋賀県草津市、代表取締役：衣斐豊祐、以下「PATENTIX」）との間で、資本業務提携に関する合意書を締結することを取締役会にて決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 資本業務提携の目的

PATENTIX が開発を進めている二酸化ゲルマニウム（以下、GeO<sub>2</sub>）は、現在主流の半導体材料であるシリコン（Si）やワイドバンドギャップ半導体（\*3）材料であるシリコンカーバイド（SiC）、窒化ガリウム（GaN）などに比べ、コスト面や様々な特長面で優位性を持ち、新規次世代半導体材料として有力視されています。

本提携により、今後は得意とする技術領域を合わせ、更なる事業領域の拡大を図るべく、GeO<sub>2</sub> 半導体のエピウエハ製造を軸とした未来品質の創造に向けた半導体ソリューションを展開いたします。

### 2. 資本業務提携の内容

今回の資本業務提携により、日電精密は、半導体製造装置及びその部品の設計・開発を行ってまいります。そして、PATENTIX と日電精密は共同で、半導体製造装置の開発・改良を進め先端半導体（GeO<sub>2</sub> 半導体）エピウエハの早期供給を実現してまいります。

### 3. Patentix 株式会社の概要

名称：P a t e n t i x 株式会社

本社所在地：滋賀県草津市野路東1丁目1番1号 立命館大学BKCインキュベータ

代表者：代表取締役社長 衣斐 豊祐

設立：2022年12月1日

資本金：1,000千円（2023年11月末時点）

#### 4. 琵琶湖半導体構想（案）

水資源が豊富な琵琶湖を中心とした広域交通基盤と半導体産業にかかわる恵まれた地理的条件を利用して、最先端半導体材料の研究開発から知財・経営戦略に立った社会実装までも網羅する国際的な半導体産業拠点を作る構想。



## 琵琶湖半導体構想（案）

### 目的

- ・経済安全保障に直結する先端半導体の確保
- ・デジタル化の基幹製品である先端半導体技術の集積化
- ・先端半導体材料による省エネ化・グリーン化

### 概要

- ・琵琶湖を中心とした広域交通基盤を利用して、世界に勝てる先端半導体材料の研究開発から製造までを一気通貫で推し進め、先端半導体エビウエハの早期供給を図ります。
- ・京都府が進める半導体産業振興施策への参加により、世界に勝てる先端半導体産業の実現に寄与します。
- ・連携体制



以上